

国泰海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司
科创板向特定对象发行股票
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年七月

声 明

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”或“公司”）委托，担任龙图光罩本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，国泰海通及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
一、发行人基本情况.....	3
二、发行人本次发行情况.....	15
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	18
四、保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...	19
五、保荐人承诺事项.....	20
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序.....	21
七、保荐人对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件的说明.....	22
八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见.....	28
九、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据.....	29
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.....	30
十一、保荐人对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论.....	31

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司中文名称	深圳市龙图光罩股份有限公司
公司英文名称	ShenZhen Longtu Photomask Co.,Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	龙图光罩
股票代码	688721
法定代表人	叶小龙
注册地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4# 厂房 101
成立日期	2010 年 4 月 19 日
上市日期	2024 年 8 月 6 日
注册资本	13,350.00 万元
邮政编码	518125
电话	0755-23207580
传真	0755-29480739
互联网网址	www.starmask.cn
电子信箱	ir@starmask.net
统一社会信用代码	91440300553875325M
经营范围	一般经营项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）发行人主营业务

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，量产产品对应下游晶圆制造的工艺节点已提升至 90nm，更高节点产品已在送样验证和规划建设中。公司掩模版产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。

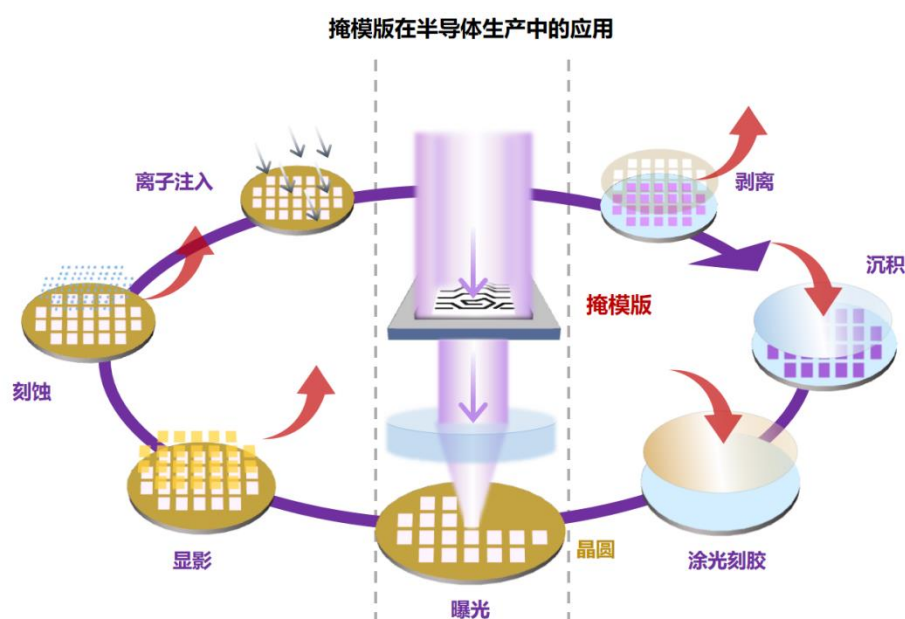
公司主要产品为掩模版，掩模版也称光罩，是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母版，承载着图形信息和工艺技术信息，广泛应用于半导体、平板显

示、电路板、触控屏等领域。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，从而实现集成电路的批量化生产。

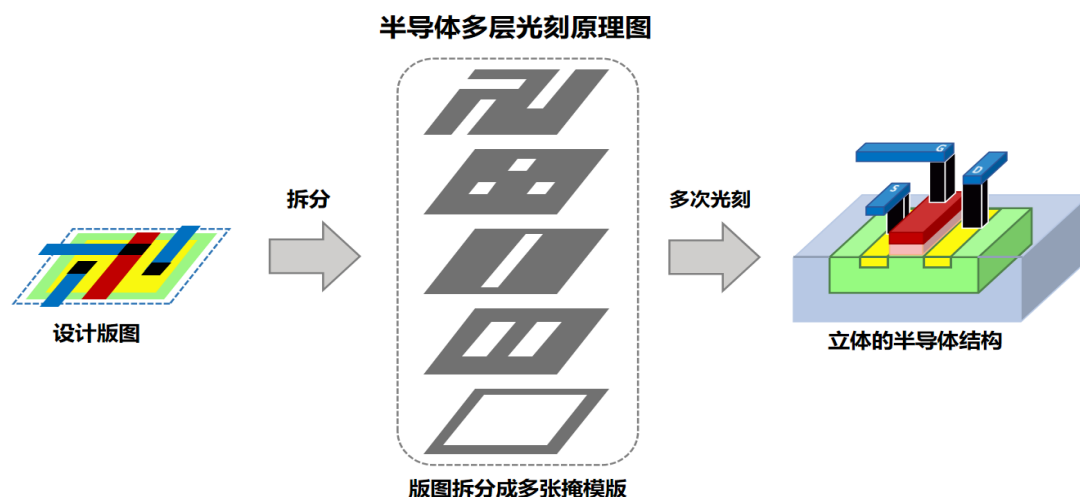
公司是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业，此外还获得广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定等。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有发明专利 29 项，计算机软件著作权 41 项。

（三）发行人主要产品及服务情况

发行人主要产品为半导体掩模版，是半导体制造工艺中的关键材料，用于半导体制造的光刻环节。半导体制造的光刻是指通过曝光工序，在晶圆表面的光刻胶上刻画出电路图形，然后通过显影、刻蚀等工艺流程，最终将电路图形转移到晶圆上的过程。掩模版在半导体生产中的应用如下图所示：



半导体器件和结构是通过生产工艺一层一层累计叠加形成的，芯片设计版图通常由十几层到数十层图案组成，芯片制造最关键的工序是将每层掩模版上的图案通过多次光刻工艺精准地转移到晶圆上（如下图所示）。半导体光刻工艺需要一整套相互之间能准确套准的、具有特定图形的“光复印”掩模版，其功能类似于传统相机的“底片”。掩模版是半导体制造工艺中最关键的材料之一，其品质直接关系到最终产品的质量与良率。



发行人生产的掩模版产品根据基板材质的不同主要分为石英掩模版、苏打掩模版两类，具体图示和介绍如下：

产品名称	产品图例	产品简介	应用场景
石英掩模版		以高纯石英玻璃为基材，具有高透过率、高平坦度、低膨胀系数等优点，成本较高，通常应用于高精度掩模版产品。	主要用于对精度要求高的功率半导体、模拟芯片、逻辑芯片等领域。
苏打掩模版		使用苏打玻璃作为基板材料，热膨胀率相对高于石英玻璃，平整度和耐磨性相对弱于石英玻璃，成本相对较低，主要用于中低精度掩模版。	主要用于对精度要求较低的中低端半导体制造、半导体封装、光学器件、触控屏和电路板制造等领域。

（四）发行人核心技术情况与研发水平

半导体掩模版高度依赖专有技术，有鲜明的“Know-How”特点。半导体掩模版的技术研发需要技术人员懂工艺、懂技术、懂设备、懂软件，对技术人员的复合能力及从业经验提出了较高的要求。公司的研发团队在半导体掩模版领域耕耘多年，具有深厚的技术积累以及良好的技术转化能力。同时，公司不断吸收和引进人才，积极与高校、科研院所开展产学研合作，提升公司研发实力，强大的人才队伍为公司技术研发与积累提供了坚实的基础，是公司研发实力的有力保证。

公司在高精度半导体掩模版领域不断进行设备引进与技术攻关，针对半导体掩模版的工艺特点，形成了多项自主研发的核心技术，包括图形补偿（OPC）技术、精准对位标记技术、光刻制程管控技术、曝光精细化控制技术、缺陷修补与异物去除技术等，涵盖 CAM、光刻、检测三大环节。同时，公司还积极开展技术布局与储备，自主研发掌握了电子束光刻及套刻技术及 PSM 相移掩模版相关技术，可满足模拟 IC 芯片等高端产品对掩模版高可靠性、高精度的要求，契合当前功率半导体、汽车电子等领域的发展需求。

报告期内，公司 PSM 和电子束光刻相关技术已开始成熟应用，并成功完成 90nm 产品的量产，同时 65nm 节点产品也已开始客户送样验证；在版图设计处理方面，公司持续发力自主研发，成功推出 AMSD、AMSC 自动化设计和检查工具，有效提升了版图处理效率和准确度，缩短了产品研发与交付周期。

凭借强大的研发实力、持续的自主创新能力以及深厚的行业经验，公司获得了国家工信部专精特新“小巨人”企业认定、广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定。截至 2026 年 3 月 31 日，公司已取得 29 项发明专利和 41 项软件著作权，具有较强的研发优势。

（五）主要经营和财务数据及指标

最近三年，公司主要经营和财务数据及指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产总计	154,683.36	131,315.43	63,158.62
流动资产合计	48,575.58	54,138.42	30,672.29
非流动资产合计	106,107.78	77,177.00	32,486.33
负债合计	33,492.24	10,928.88	7,834.29
流动负债合计	10,896.16	9,608.49	6,755.79
非流动负债合计	22,596.08	1,320.40	1,078.50
所有者权益合计	121,191.12	120,386.54	55,324.33
归属于母公司所有者权益合计	121,191.12	120,386.54	55,324.33

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
少数股东权益	-	-	-

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	24,665.83	24,650.35	21,829.27
营业成本	13,486.99	10,597.83	8,979.02
营业利润	5,764.23	10,199.93	9,542.06
利润总额	5,763.74	10,201.00	9,526.08
净利润	5,608.85	9,183.29	8,360.87
归属于母公司所有者的净利润	5,608.85	9,183.29	8,360.87

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,027.02	10,923.48	10,147.81
投资活动产生的现金流量净额	-15,003.89	-82,039.33	-13,133.81
筹资活动产生的现金流量净额	19,626.46	55,398.93	-398.76
现金及现金等价物净增加额	12,648.51	-15,717.19	-3,387.60

4、报告期主要财务指标

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
流动比率（倍）	4.46	5.63	4.54
速动比率（倍）	4.35	5.51	4.41
资产负债率（母公司）	5.59%	3.93%	8.63%
应收账款周转率（次/年）	3.44	3.79	3.81
存货周转率（次/年）	9.75	10.37	10.59
息税折旧摊销前利润（万元）	9,436.37	12,124.57	11,356.96
利息保障倍数	101.04	1,645.12	-
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,608.85	9,183.29	8,360.87
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,429.59	9,035.96	8,178.67
研发投入占营业收入比例	11.10%	9.35%	9.24%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.60	0.82	1.01

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
每股净现金流量（元）	0.95	-1.18	-0.34
归属于发行人股东的每股净资产（元）	9.08	9.02	5.53

注：上述财务指标计算公式：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债；
- 3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；
- 4、应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款账面余额；
- 5、存货周转率=营业成本÷平均存货账面余额；
- 6、息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销额；
- 7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出；
- 8、研发投入占营业收入比例=研发费用÷营业收入；
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额；
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额；
- 11、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计÷期末股本总额。

（六）发行人存在的主要风险

1、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（1）技术风险

①产品迭代风险

半导体掩模版是芯片制造的关键工具，对晶圆光刻的质量有重要影响。公司第三代半导体掩模版产品 PSM 目前处于批量供货前期，若公司不能继续保持充足的研发投入以满足技术研发的需求，在关键技术上未能持续创新，或新产品开发未能满足更多下游客户需求，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。

②关键技术人才流失风险

掩模版行业作为技术密集型产业，在产品研发和生产经营过程中，需要足够的研发技术人员。我国半导体掩模版起步较晚，关键技术人才稀缺。如果公司对研发技术人员的激励安排与同行业竞争对手相比丧失优势，或由于其他原因导致研发技术人员流失，则可能对公司的市场竞争能力和持续盈利能力造成不利影响。

（2）经营风险

①主要原材料和设备依赖进口且供应商较为集中的风险

公司的主要原材料为石英基板、苏打基板和光学膜等。石英基板和光学膜技术门槛高，全球供应高度集中于日本、中国台湾等地区的少数厂商，公司存在显著的进口依赖；报告期内，公司向前五大供应商采购原材料的金额占原材料总采购金额的平均比例为 71.87%，供应商集中度较高。公司主要生产设备如光刻机等，亦主要向境外供应商采购。

当前，中美、中日地缘政治关系复杂多变，叠加半导体领域贸易保护主义抬头，全球半导体供应链正面临重构压力。尽管目前贸易限制政策主要针对先进制程相关产品，但不排除未来上述国家进一步扩大限制范围，将公司现有制程涉及的设备、材料纳入管制范畴，从而导致采购成本上升、交货周期延长甚至断供风险，对公司生产经营的连续性与稳定性产生不利影响。此外，若地缘政治冲突加剧导致供应链受阻，或核心供应商自身经营状况、交付能力发生重大不利变化，亦将直接影响公司的生产组织与订单交付，进一步凸显供应链安全面临的挑战。

②产品质量控制的风险

公司主要产品掩模版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心材料，是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单，向客户提供符合其品质指标要求的产品，如果未来公司出现重大产品质量事故，将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

③原材料价格波动风险

报告期内，公司产品的生产成本中直接材料占比平均为 50.18%，且主要由基板和光学膜构成，上述材料的价格波动对公司产品成本的影响较大。如果受贸易政策或全球市场供应紧张等因素影响，上述原材料价格出现大幅波动，公司又不能及时将价格压力传导至下游客户，将会对公司的毛利率和盈利能力产生不利影响。

④知识产权保护与技术泄密的风险

在掩模版行业的发展与竞争中，相应的知识产权保护体系至关重要，也是获取竞争优势与长期发展的关键要素。公司结合多年的上下游匹配与服务经验，形成了大量的专有技术，具有鲜明的“Know-How”特点。由于专有技术保护措施的限制性及其他不可控因素，公司存在核心技术泄密的风险。未来如果公司核心技术相关内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽等行为而导致核心技术泄露，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

（3）财务风险

①毛利率水平下滑的风险

2025 年度，公司主营业务毛利率为 45.29%，同比减少 11.72 个百分点。若未来竞争对手加大市场开拓力度或采取低价竞争手段，或下游半导体行业的整体需求大幅下降或半导体产品创新周期拉长，或主要原材料受贸易政策限制、全球市场供应紧张等因素影响价格上涨，以及珠海募投项目投产后固定资产折旧分摊大幅提升，抑或人工成本大幅上升，且公司不能适时调整适应市场竞争策略或产品成本控制不力，均将可能导致公司面临毛利率继续下降的风险。

②经营业绩下滑风险

报告期内各期，公司营业收入分别为 21,829.27 万元、24,650.35 万元和 24,665.83 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 8,178.67 万元、9,035.96 万元和 5,429.59 万元，最近一年公司净利润存在一定程度的下滑，主要系一方面 130nm 及以上制程半导体掩模版市场进入国产替代后期，市场竞争有所加剧导致销售单价有所下滑；另一方面，珠海新厂处于产能爬坡期，固定成本分摊较高，导致产品毛利率为负且计提了较多原材料跌价损失所致。公司经营业绩受到宏观经济波动、产业政策调整、市场需求改变、市场竞争加剧等诸多外部因素影响，若未来 130nm 及以上制程半导体掩模版产品销售单价进一步下降，公司珠海工厂产能释放及下游客户产品认证不及预期，外部因素发生重大不利变化或未得到有效改善，存在公司业务利润不及预期，甚至持续下滑的风险。

③应收账款回收风险

随着公司经营规模不断扩大，公司应收款项也相应增长。2025 年末，应收账款账面价值为 7,200.76 万元，占期末流动资产的比例为 14.82%，占当期营业收入的比例为 29.19%。报告期内，公司主要对应收账款计提了坏账准备，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险；如若客户信用风险集中发生，将会对公司财务状况产生不利影响。

④汇率波动风险

报告期内公司通过外币结算的采购金额占原材料采购金额的比例为 35.92%，公司新增光刻机等重要设备亦为境外采购，公司境外采购的主要结算货币为美元、日元和欧元。随着公司销售规模及工艺节点提升，新增境外采购设备及进口原材料亦将持续增长，如果未来汇率发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

（4）行业风险

①市场竞争不断加剧的风险

当前全球半导体掩模版市场呈现高度集中的寡头垄断格局，日本科盛德、美国 Photronics、日本 DNP 三家主导市场，占据独立第三方掩模版市场 80%以上的市场份额，技术节点已突破至 7nm 以下，并在设备、工艺和客户黏性上形成深厚壁垒，占据着显著的市场竞争优势。近年来，在产业政策推动及国产替代需求下，半导体掩模版行业发展态势向好，吸引了多家新兴光罩企业进入和布局，伴随行业新增产能的逐步释放，国内光罩市场竞争日趋激烈。

公司经过多年的发展与积累，通过工艺迭代与大量新产品的开发、生产实践，积累了丰富的产品开发和生产经验，但相较于全球龙头企业，公司在技术先进性、市场竞争力上仍存在一定差距，同时面对国内新入局光罩厂的快速布局与竞争，也面临着新的市场挑战。未来，若国际主要竞争对手为稳固中国大陆市场份额加大投入，新兴光罩厂加速产能与技术突破并为争夺市场采取价格竞争等手段，将进一步加剧行业竞争程度，对公司的经营业绩产生不利影响。

②技术替代风险

目前全球范围内半导体、平板显示等行业主要采用掩模版为基准图案进行曝光量产。截至目前，由于芯片直写光刻技术对于大批量半导体晶圆制造而言光刻速度过慢而未被证明是一项商业化可行的替代技术。但如果未来无需使用掩模版的芯片直写光刻技术，或其他替代性图形转移技术获得了技术突破并取得下游市场的广泛应用，而公司由于资源、技术或其他限制，不能够很好地应对或跟进这些技术变化，公司的运营及业绩将受到不利影响。

（5）宏观环境风险

①宏观经济波动带来的风险

当前全球贸易保护主义持续抬头，中美、中日双边关系变化下半导体领域的贸易与技术管制政策不确定性显著加剧，给行业发展带来多重外部挑战。若未来中美、中日之间的贸易限制与技术管制进一步升级，将直接对公司半导体掩模版业务的技术升级研发、高端生产设备引进、核心原辅材料进口造成显著制约，同时也会影响公司海外市场开发与全球化业务布局的推进节奏，给公司供应链稳定性、技术迭代效率及市场拓展带来多重不确定性风险，进而对公司生产经营与持续发展造成不利影响。

②产业政策变化风险

半导体产业是国家战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强了中国半导体产业的创新能力和国际竞争力，带动了整个产业的发展。但若未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下滑、税收优惠减少、政府补贴金额下降等，公司的经营业绩可能会因此受到不利影响。

2、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（1）本次发行失败的风险

本次向特定对象发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会注册，上交所是否审核通过、中国证监会能否予以注册，以及最终上交所审核通过、中国证监会予以注册的时间均存在不确定性。因此，本次发行存在发行失败的风险。

（2）募集资金不足的风险

本次发行股票数量不超过 40,050,000 股（含本数），募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数），在扣除发行相关费用后拟用于“40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目”。但若二级市场行情波动导致公司股价大幅下跌，存在筹资不足的风险，从而导致募集资金投资项目无法顺利实施。

3、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

（1）募投项目无法顺利实施的风险

公司本次发行募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、公司现有业务状况和未来发展战略等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。若前述因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的投资进度、建设过程及实施结果等将存在一定的不确定性，募投项目亦可能面临无法按期顺利实施的风险。

（2）募投项目新增产能难以消化的风险

本次募投项目的成功实施将显著提升公司更高制程半导体掩模版的研发、生产能力，公司将新增每年稳定产出 15,000 片半导体掩模版，在产品结构上，除现有的二元掩模版和相移掩模版外，增加更高制程的 KrF-PSM、ArF-PSM 以及 OMOG 掩模版产品，可促使公司更好服务下游客户因产线扩建、工艺升级而日益增长的需求。但若未来出现国际国内形势发生重大不利变化、半导体下游市场增长不及预期、下游客户产品认证无法通过或不及预期等不利情况，公司将面临新增产能难以消化及募投项目短期内无法盈利的风险。

（3）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

IPO 募投项目及本次募投项目中公司投入较高金额用于高端机器设备的购置，本次募投项目达产后预计每年固定资产折旧费用将有所增加，预计达产后 IPO 募投项目及本次募投项目年均新增折旧摊销 23,958.70 万元，约占 IPO 及本次募投项目预计新增营业收入的 16.64%，约占预计新增净利润的 56.27%，将对公司的业绩存在一定影响。虽然公司已根据行业发展趋势和公司现有技术能力，对本次募投项目的经济效益经过了合理测算，预计可抵消上述固定资产折旧对经营业绩的影响，但公司客观上仍存在诸多可能导致募投项目无法按照预期实现经

经济效益的风险，主要包括：1、随着制程向更先进和更高端发展，半导体材料技术迭代和攻关过程中将面临诸多客观挑战，包括众多 Know-how 探索、设备磨合以及客户工艺融合等。上述情形均可能延缓既定项目的研发及量产进度。公司本次募集资金项目拟投向 40nm-28nm 半导体掩模版项目（国内独立第三方掩模版厂商目前所能达到的最高端制程范围），尽管公司已审慎评估技术上的可行性，但在具体实施本次募投项目的工艺技术前，仍难以完全预估各种因素挑战，因此公司存在无法按照既定进度推进募投项目的风险；2、目前本项目所对应的高端掩模版领域，下游客户长期沿用境外供应商的掩模版参数并已相对固化其工艺窗口（主要因为该制程范围的第三方掩模版厂商以国外企业为主），公司需要通过精细化的工艺窗口复现以消除因掩模版差异带来的制程波动，这一过程中涉及到大量的调试与优化工作。加之不同客户之间存在差异，预计公司与下游客户的工艺磨合周期将更长，甚至存在公司产品难以通过重点客户验证的风险；3、即使公司顺利推进该项目研发及客户验证等，由于下游客户从认证通过到下达订单，客观存在交易量爬坡过程，公司存在本次募投项目商业订单达到预定规模的周期延后风险；4、下游客户通常选择多家合作伙伴进行产品验证。若竞争对手率先通过客户认证并占据大量份额，或采取价格竞争策略获取订单，公司存在募投项目产能消化不及预期风险。上述风险因素进而导致募投项目实施后产能释放滞后，产能消化不及预期，新增毛利难以覆盖折旧摊销增量，将导致业绩不达预期。在营业收入增长不及预期的情形下，折旧摊销大幅增加导致的收入与折旧错配将对公司未来业绩产生不利影响，公司面临募投项目实施后业绩下滑、甚至亏损的风险。

（4）即期回报被摊薄的风险

本次发行完成后，公司股本规模和净资产规模将相应增加。虽然本次募集资金到位后，公司将高效利用募集资金以提升公司运营能力和长期盈利能力，但受国家宏观经济、行业发展情况募投项目建设期的影响，短期内项目的效益及公司的盈利状况仍然存在一定的不确定性，因此本次发行后公司股东即期回报将可能面临被摊薄的风险。

4、其他风险

（1）股票价格风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（2）不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财产、人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响公司盈利水平。

二、发行人本次发行情况

（一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

（三）发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的

规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股数或转增股本数，调整后发行底价为 P_1 。

最终发行价格将在公司获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士在股东会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票的数量不超过发行前公司总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的 30%，即本次发行的股票数量不超过 40,050,000 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销股票等事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象认购的 A 股股票，自本次向特定对象发行股票结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

发行对象基于本次发行所取得的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律、法规、规范性文件以及上交所、中国证监会的相关规定。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。

（八）公司滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按照本次发行后的股份比例共享或承担。

（九）募集资金用途及数额

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目	195,436.81	146,000.00
合计		195,436.81	146,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行

费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

（十）决议有效期

本次发行决议的有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算。

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人

国泰海通证券指定殷凯奇、熊伟作为龙图光罩本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

殷凯奇先生，本项目保荐代表人，注册会计师，国家法律职业资格，美国密歇根大学安娜堡分校硕士。2017 年起从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：深圳新星（603978）、英搏尔（300681）、新城市（300778）、南极光（300940）、峰岬科技（688279）、龙图光罩（688721）等 IPO 项目的改制或申报工作；同兴达（002845）和南极光（300940）非公开发行项目、中环环保（300692）可转债发行项目；爱迪尔（002740）、海航科技（600751）重大资产重组项目。殷凯奇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

熊伟先生，本项目保荐代表人，注册会计师，国家法律职业资格，对外经济贸易大学硕士。2022 年起从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：恒昌医药、长步道等 IPO 项目以及三地一芯（874979）等挂牌项目。熊伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：王树。

其他项目组成员：王子龙、严胜、贾文静。

（三）保荐人指定保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系地址、电话

联系地址：广东省深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城写字楼 A 座 43 层

联系电话：0755-25860625

四、保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，本保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

截至 2025 年 12 月 31 日，海通创新证券投资有限公司通过履行保荐机构跟投职责而进行入股持有 166.88 万股，占总股本的 1.25%；国泰海通证券股份有限公司证券衍生品投资部持有 99 股公司股票，占公司总股本的 0.00%；国泰海通证券股份有限公司融资融券部自营账户持有 6,700 股公司股票，占公司总股本的 0.01%。截至 2025 年 12 月 31 日，国泰海通证券股份有限公司及其子公司合计持有发行人股份数量占发行人总股本的 1.26%。

除上述情况外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

截至本上市保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况：

截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况：

截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）关于保荐人与发行人之间其他关联关系的说明：

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在影响保荐人公正履行保荐职责的其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人对本次上市保荐的一般承诺

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，并组织编制了申请文件，同意推荐发行人本次发行，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐人对本次上市保荐的逐项承诺

保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条的规定，做出如下承诺：

“（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上海证券交易所规定的其他事项。”

保荐人承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，接受上海证券交易所的自律监管。

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序

（一）本次发行已取得的授权和批准

1、董事会审议过程

2026年3月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。

2、股东会审议过程

2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了前述与本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票相关的议案。

（二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准

- 1、本次向特定对象发行股票尚需经上交所审核通过；
- 2、本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册。

七、保荐人对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件的说明

（一）本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定

1、本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定

发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票，每股面值 1 元，每一股份具有同等权利；每股的发行条件和发行价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百四十三条之规定。

2、本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，本次发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百四十八条之规定。

3、本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定

发行人已于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，符合《公司法》第一百五十一条之规定。

4、本次发行不存在《证券法》第九条禁止性规定的情形

发行人本次发行将向特定对象发行。本次发行将不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第九条的相关规定。

综上所述，本次发行符合《公司法》《证券法》的有关规定。

（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明

1、公司本次发行符合《注册管理办法》第十一条的相关规定

保荐人查阅了《内部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》《审

计报告》等文件，发行人现任董事、高级管理人员无犯罪记录证明，发行人及其子公司主管部门开具的合规证明或企业信用报告（无违法违规证明版），发行人及实际控制人出具的说明，及通过互联网公开信息进行检索。

经核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途，发行人报告期内财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，最近一年会计师出具了标准无保留意见的审计报告。发行人及实际控制人、现任董事、高级管理人员合法合规，不存在《注册办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；

（3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、公司本次发行符合《注册管理办法》第十二条的规定

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件。发行人本次发行募集资金扣除发行费用后的金额将全部投入 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目，本次募集资金投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中列明的限制类和淘汰

类产业，亦不属于《国务院关于进一步加强对落后产能工作的通知》等规定中的需要淘汰的落后产能、需要化解的过剩产能行业；本次发行募集资金投资项目所使用的土地、房产均已依法取得权属证书，不存在违法用地的情形。因此，本次发行募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《注册办法》第十二条第一项的规定。

（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件，经核查，发行人本次发行募集资金将全部投入 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目，不存在用于持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形，符合《注册办法》第十二条第二项的规定。

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件，经核查，发行人本次发行募集资金投资项目均由发行人全资子公司珠海龙图自行实施，不涉及与其他主体合作的情形。本次募集资金投资项目与发行人现有主营业务密切相关，本次募投项目实施后，不会与实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册办法》第十二条第三项的规定。

（4）科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件，经核查，发行人本次发行募集资金项目为 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域，符合《注册办法》第十二条第四项的规定。

综上，本次发行符合《注册管理办法》第十二条的规定。

3、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件。经核查，本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

综上，本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的相关规定。

4、本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条、第五十八条和第五十九条的规定

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件。经核查：

（1）本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

（2）本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，符合《注册管理办法》第五十八条的规定。

（3）本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

综上，本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条、第五十八条和第五十九条的规定。

5、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件。经核查，公司及其实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

6、本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定

保荐人查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议、股东会决议、募集说明书等相关文件。经核查，公司的实际控制人为柯汉奇、叶小龙和张道谷，柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有龙图光罩 19.75%、19.75%、14.67%股权，柯汉奇通过深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙)控制公司 2.82% 股权，三人合计控制龙图光罩 56.99%股权，处于绝对控制地位；若按本次发行股份上限计算，发行后上述持股比例降为 43.84%，仍处于控制地位。本次向特定对象发行不会导致发行人控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

(三) 本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

1、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一项的规定

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未持有金额较大的财务性投资。本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本上市保荐书签署日期间，公司不存在实施或拟实施财务性投资的情形。

保荐人认为，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一项的规定。

2、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二项的规定

经核查，发行人及其实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

保荐人认为，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二项的规定。

3、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四项的规定

经核查，发行人本次发行股票数量上限不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即本次发行不超过 4,005.00 万股；本次发行董事会决议日（2026 年 3 月）距离前次募集资金到位日（2024 年 8 月）不少于十八个月，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四项关于融资规模与融资时间间隔的相关规定。

4、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五项的规定

经核查，发行人募集资金全部投资于“40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目”，募集资金不投入在支付人员工资、预备费、市场推广费等非资本性支出中，均投入于装修工程、设备采购等资本性支出，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五项的规定。

（四）本次发行程序合法合规

2026 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。

2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了前述与本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票相关的议案。

董事会决议以及相关文件已在上交所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。

综上，本次发行的审议程序合法合规。

八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见

（一）本次募集资金投向符合国家产业政策，主要投向科技创新领域

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，目前已完成90nm制程节点半导体掩模版的量产，65nm制程节点产品也已开始送样验证。公司掩模版产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、先进封装等特色工艺制程。

“深耕特色工艺，突破高端制程”是公司始终贯彻的中长期发展规划。本次募集资金将投向40nm-28nm半导体掩模版生产线建设项目，该项目不仅是公司前次募投项目的扩建与延续，更是公司保持行业地位、巩固市场竞争力的必经之路。通过本次募投项目的实施，公司将具备28nm半导体掩模版的制程能力，进一步提升工艺水平与竞争实力，满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，本次募投项目面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

28nm制程能力是当前衡量我国掩模版企业技术实力的核心标杆。从行业格局看，第三方掩模版市场普遍以28nm为重要分界线：一方面，在28nm及以下的先进制程领域，由于境外掩模版厂商具有资本投入的先发优势和产业链集群优势，同时中国大陆半导体行业受贸易制裁、出口管制等多因素影响，当前国内能

够自主量产 28nm 以下制程掩模版的企业数量极少；另一方面，能够突破 28nm 制程技术壁垒，是当前我国第三方掩模版企业构建差异化竞争优势、巩固市场地位的关键路径，亦是其持续保持技术引领力的必然要求。通过公司本次募投项目的实施，公司半导体掩模版将具备 28nm 制程能力，能够有效填补国内高端光掩模版的市场缺口，推动我国半导体产业链的协同发展，加速半导体材料的国产化进程，为我国集成电路产业的高质量发展提供坚实支撑。

（三）核查意见

经核查，本保荐人认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。通过本次募投项目的实施，将有力保障发行人的产品技术优势及市场领先地位。本次募集资金投向属于科技创新领域。

九、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，公司产品属于“先进半导体材料和新型显示材料”中的“光掩模版”；根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司主营业务属于“信息产业”中的“集成电路”，属于“鼓励类”领域；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2、电子核心产业”中的“1.2.1、新型电子元器件及设备制造”和“1.2.4、集成电路制造”。半导体和集成电路产业是我国当前重点发展的战略性新兴产业之一。

公司的主要产品为掩模版，是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母版，承载着图形信息和工艺技术信息。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，从而实现集成电路的批量化生产。掩模版作为芯片光刻的“母版”，用于半导体制造的光刻环节。半导体制造的光刻是指通过

曝光工序，在晶圆表面的光刻胶上刻画出电路图形，然后通过显影、刻蚀等工艺流程，最终将电路图形转移到晶圆上的过程。

半导体掩模版作为半导体制造关键材料之一，由于其技术壁垒较高，国内市场长期由国际大厂所占据，如美国 Photronics、日本 Toppan、日本 DNP 等，国内厂商市场影响力尚低。公司长期聚焦半导体掩模版研发，不断实现技术创新和产品迭代升级，掩模版制程能力和下游应用领域不断扩展，成功进入了国内众多知名半导体厂商供应商名录并建立起稳定的合作关系，并在部分制程节点上占据了境外半导体掩模版厂商的市场份额，实现了进口替代。

我国政府颁布了一系列政策法规，大力扶持集成电路及半导体材料领域的发展。公司符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025 年）》等一系列产业政策。

自 2024 年 8 月登陆科创板以来，公司始终坚持主业经营，主营收入主要来源于核心技术，商业模式未发生重大变化，具备较高的市场认可度和良好的社会形象。

保荐人查阅了《国民经济行业分类》以及发行人所处行业的相关法律法规、产业政策，了解了发行人所处行业的发展概况、公司所处行业地位，认为发行人符合科创板板块定位，符合国家产业政策。

十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

发行人证券上市后，本保荐人将严格按照《证券法》《保荐管理办法》《注册管理办法》等法律法规的要求对发行人实施持续督导，持续督导期间为发行人股票上市当年剩余时间以及其后两个完整会计年度。

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；（2）与发行

事项	工作安排
利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况 及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	(1) 督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易决策制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；(2) 督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	(1) 督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；(2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；(2) 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；(3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务
6、持续关注发行人对外担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》等相关制度以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项检查
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定，及时通报与保荐工作相关的信息；(2) 列席发行人的股东会、董事会和审计委员会；(3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；(2) 接受保荐人尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
(四) 其他安排	本保荐人将严格按照中国证监会、上海证券交易所的各项要求对发行人实施持续督导

十一、保荐人对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论

发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件等规定中关于科创板上市公司向特定对象发行股票的相关要求；发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，募集资金投向属于科技创新领域，具备科创板上市公司向特定对象发行股票的基本条件；本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，本保荐人同意推荐发行人深圳市龙图光罩股份有限公司股票在贵所上市交易。

请予批准！

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司科创板向特定对象发行股票之上市保荐书》的签字盖章页）

项目协办人：

王树
王 树

保荐代表人：

殷凯奇
殷凯奇

熊伟
熊 伟

内核负责人：

杨晓涛
杨晓涛

保荐业务负责人：

郁伟君
郁伟君

保荐机构法定代表人（董事长）：

朱健
朱 健


国泰海通证券股份有限公司
2026 年 7 月 16 日